



RE212-HP

- Carta in resina fenolica FR2 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Protezione organica per superfici (OSP)
- Maschera di saldatura
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 rilievi di saldatura 2,10 mm Ø
- Diametro del foro 1,00 mm
- Tutti i rilievi di saldatura sono collegati con percorsi di conduzione orizzontali e verticali
- Un'interruzione manuale dei percorsi di conduzione sottili consente un creazione semplice del proprio layout
- Dimensioni 100 x 160 mm